

产品规格书

3121N-ISF

PLC-IoT 模组

Version: v1.2 (PS0211)

客户:	
客户 P/N:	
签名:	
日期:	

办公室: 广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 50 号凤凰智谷 B座 14层

工厂: 中国湖南省长沙市浏阳经济技术开发区利通路8号

TEL: +86-755-2955-8186 Website: www.fn-link.com



3121N-ISF 模组规格书

Ordering	Part NO.	Description
	FG3121NISF-01	PLC 模组, PS0211, 22.3*13*2.25mm, UART, PWM,
	FG3121NISF-01	GPIO, 22pin 邮票孔



CONTENTS

1	概述	5
	1.1 介绍	5
	1.2 特性	5
	1.3 通用规格	7
	1.4 推荐工作条件	7
2	模组引脚定义	8
	2.1 模组外观	8
	2.2 引脚框图	8
	2.3 引脚定义	9
3	模组封装尺寸	. 11
4	硬件设计说明	. 11
	4.1 输入电源要求	.11
	4.2 CCO 和 STA 典型组网示意图	.12
5	关键物料清单	.12
6	推荐回流焊曲线	13
7	标签信息	14
	7.1 模组标签	.14
	7.2 包装标签	.14
8	包装信息	15
	8.1 编带方式	.15
	8.2 编带尺寸	.15
	8.3 其他包装信息	16
	8.4 备用吸塑包装方式及其他	.17
9.	湿度敏感性	.17



修订历史

Version	Date	Contents	Draft	Checked	Approved
V1.0	2022/08/23	PS0211 方案初版	FC	TZ	QJP
V1.1	2023/01/14	套用新规格书格式;增加 PWM 相关功能描述;修正部分列印错误。	FC	LSP	QJP
V1.2	2023/11/15	增加长宽高公差值 增加包装信息 删除 PLC 模组对接整机设计	LXP	LSP	QJP



1 概述

1.1 介绍

3121N-ISF 是一款全集成的电力载波(PLC)通讯模块,超小型化尺寸、结构紧凑、布线简单,可广泛应用于智能路灯、智能家居、智慧停车、中央空调及泛在电力物联网末端设备等各种 PLC 即时通讯应用场景。

3121N-ISF 基于 PS0211 芯片, 其集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及 ARM Cortex-M3 处理器。PS0211 芯片支持 P1901.1, 支持 OFDM/FSK 调制。

3121N-ISF 提供 UART、PWM、GPIO、SPI、ADC 等丰富的外设接口,集成了内置线驱 Line-Driver。

1.2 特性

CPU 和存储性能

- 高性能 Cortex-M3 处理器, 工作频率 200MHz
- 内嵌 SRAM 256KB

物理层特性

- 实现 IEEE 1901.1 标准子集,对于同样使用该子集的芯片,能够实现互联互通
- 支持 0.5-3.7MHZ 和 2.5-5.7MHZ 两个频段, 频段可由软件配置。
- 采用 OFDM 技术,支持 BPSK、QPSK 调制模式
- 支持 FEC 和 CRC 功能, 强大的去噪和纠错能力

MAC 特性

- 支持 TDMA 和 CSMA/CA, 提供冲突避免机制
- 支持数据分段和重组,提高传输效率
- 支持数据重传机制
- 支持 4 级 QoS,满足不同业务服务质量需求

组网特性

- 支持自动快速组网,典型 200 规模、2 层级网络的场景 10s 完成快速组网,支持快速通信
- 支持动态路由, 多路径寻址

外围接口

UART \ GPIO \ PWM \ SPI \ ADC

通信指标

- 物理层峰值速率 0.507Mbit/s, 应用层速率 80Kbps
- 接收灵敏度优于 0.2mVpp

功耗及其他

● 静态功耗≤0.15W(组网不发包)



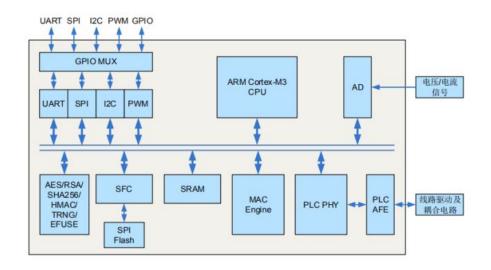
● 动态运行功率≤0.7W

● 工作环境温度范围:-40℃~+85℃

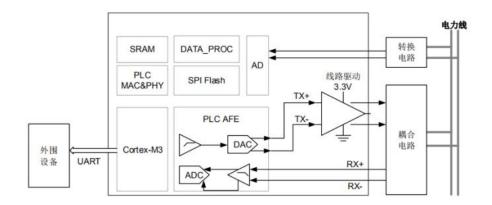
● 存储温度范围:-40°C to 125°C

模块框图

模块内部功能框图:



模块典型应用框图:





1.3 通用规格

模块名称	3121N-ISF
主IC	PS0211
主要接口	UART, PWM, GPIO, SPI, ADC
通信方式	电力线载波通信,支持 P1901.1,支持 OFDM/FSK 调制
尺寸	Lx W x H : 22.30(-0.1~+0.3)mm*13.00(-0.1~+0.3)mm*2.25(±0.2)mm

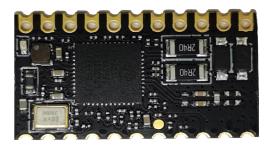
1.4 推荐工作条件

工作电压	3.3 V ± 100mV
工作温度	-40°C to +85°C
存储温度	-40°C to +125°C

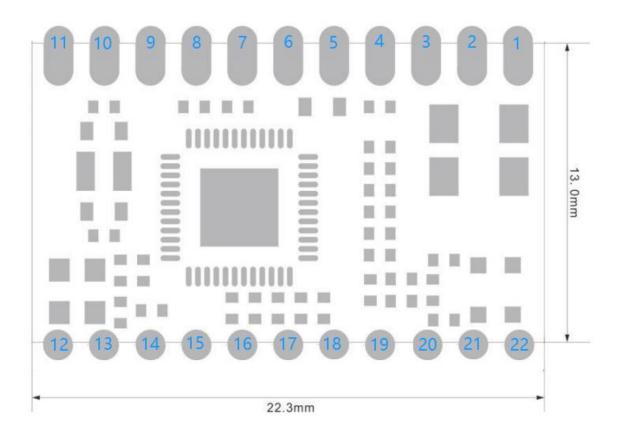


2 模组引脚定义

2.1 模组外观



2.2 引脚框图





2.3 引脚定义

引脚定义及复用说明:

PIN NO.	PIN 定义	备注说明	
1	PLC-	PLC- 通信口,需设计防护和耦合电路隔离 AC 电源;一般要求随护能力:差模/共模±4KV	
2	PLC+	PLC+ 通信口,需设计防护和耦合电路隔离 AC 电源;一般要求 护能力:差模/共模±4KV	
3	GND	参考地	
4	3V3	电源输入	
5	UART0_RX	复用信号 0: GPIO_9,通用输入输出 复用信号 1: UARTO_RX,业务串口接收,用于和外部 MCU 通信	
6	UART0_TX	复用信号 0: GPIO_10,通用输入输出 复用信号 1: UART0_TX,业务串口发送,用于和外部 MCU 通信	
7	GPIO15	复用信号 0: GPIO_15,通用输入输出,支持软件模拟 PWM复用信号 1: SPI1_CK , SPI1 从设备时钟复用信号 2: SSP1_CK,SPI 主设备时钟复用信号 3: LED4,通用 LED复用信号 4: EFUSE_PW_E,EFUSE 的 AVDD 电源控制信号	
8	GPIO3	复用信号 0: GPIO_3,通用输入输出,支持软件模拟 PWM 复用信号 1: LED2,通用 LED 复用信号 3: SSP2_DI,SPI2 数据输入信号 复用信号 4: SSP2_DO,SPI2 数据输出信号	
9	GPIO1	复用信号 0: GPIO_1,通用输入输出,支持软件模拟 PWM 复用信号 1: LED5,通用 LED 复用信号 3: SPI2_CK,SPI2 从设备时钟输入 复用信号 4: SSP2_CK,SPI2 主设备时钟输出	
10	GPIO0	复用信号 0: GPIO_0,通用输入输出 复用信号 1: LED4,通用 LED 复用信号 3: PWM_OUT,PWM0 数据输出,占空比可调范围 1~1/65535	
11	GPIO2	复用信号 0: GPIO_2,通用输入输出,内部有 10K 上拉复用信号 1: LED1,通用 LED复用信号 3: SPI2_CSN,SPI2 从设备片选输入信号,低电平有效复用信号 4: SSP2_CSN,SPI2 主设备片选输出信号,低电平有效	



12	GPIO20	复用信号 0: GPIO_20,通用输入输出,内部有 10K 上拉		
13	GPIO12	复用信号 0: GPIO_12,通用输入输出		
14	GPIO4	复用信号 0: GPIO_4,通用输入输出,支持软件模拟 PWM 复用信号 1: LED3,通用 LED 复用信号 3: SSP2_DO,SPI2 数据输出信号 复用信号 4: SSP2_DI,SPI2 数据输入信号		
15	GPIO16	复用信号 0: GPIO_16,通用输入输出,支持软件模拟 PWM 复用信号 1: SPI1_CSN,SPI1 从设备片选输入信号,低电平有效 复用信号 2: SSP1_CSN,SPI1 主设备片选输出信号,低电平有效 复用信号 3: LED5,通用 LED		
16	GPIO18	复用信号 0: GPIO_18,通用输入输出,支持软件模拟 PWM 复用信号 1: SSP1_DO,SPI1 数据输出信号 复用信号 2: SSP1_DI,SPI1 数据输入信号 复用信号 3: LED2,通用 LED		
17	EFUSE	Efuse 电源,不使用则悬空(通常不建议单板进行 EFUSE 编程操作)		
18	UART1_TX	复用信号 0: UART1_TXD,UART1 数据发送,用于烧录测试和LOG 输出		
19	UART1_RX	复用信号 0: UART1_RXD,UART1 数据接收,用于烧录测试		
20	VIN4	ADC 输入,输入电压范围 0.1~2.75V,分辨率 12bit		
21	GPIO17	复用信号 0: GPIO_17,通用输入输出,支持软件模拟 PWM 复用信号 1: SSP1_DI,SPI1 数据输入信号 复用信号 2: SSP1_DO,SPI1 数据输出信号 复用信号 3: LED1,通用 LED		
22	GPIO5	复用信号 1: GPIO_5,通用输入输出复用信号 3: PWM_OUT_1,PWM1 数据输出,占空比可调范围1~1/65535(此管脚上电初始化会有一段 800ms 高电平,灯控应用会存在上电瞬间闪灯的情况,酌情使用)		

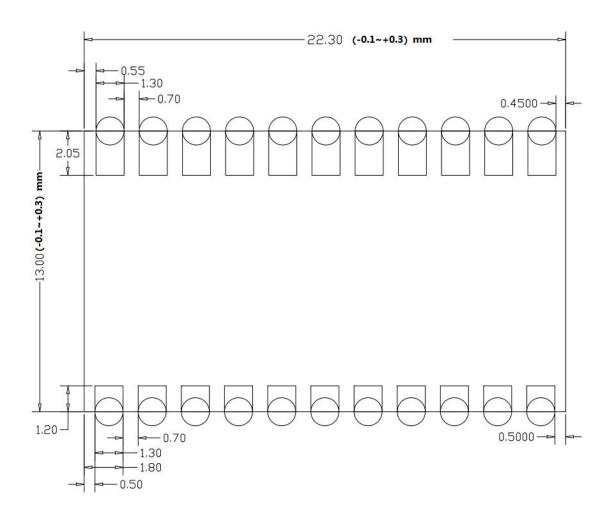
备注 1:IO 电压域为 3.3V。

备注 2:对于无内部 10Kohm 下拉电阻的 GPIO,则上电瞬间会有一段高电平,用于灯控照明应用时可能会导致上电瞬间闪灯,此类应用建议在主板上给对应 IO 加 10k 下拉电阻。



3 模组封装尺寸

单位: mm



4 硬件设计说明

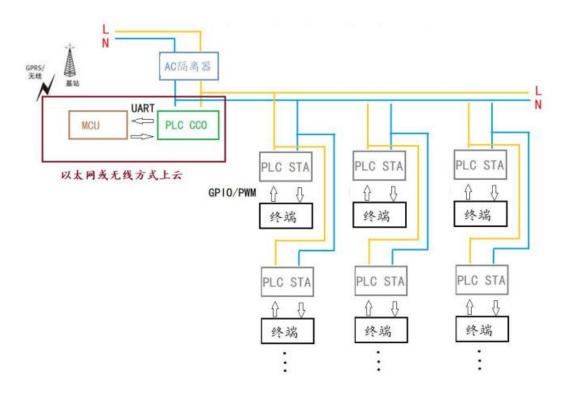
4.1 输入电源要求

输入电压	Min.	Тур.	Max.	Unit
3.3Vin	3.0	3.3	3.6	V

- 主板靠近模组 3.3V 输入端,至少放置一个 10uF, 0.1uF 对地储能电容,降低电源纹波,纹波峰峰值 100mVpp 以内。
- 模组 3.3V 与主板其他 3.3V 使用 600R/100MHz, 耐流 1A 及以上磁珠隔离。
- 模组 3.3V 电路至少保障 200mA 及以上电流需求。



4.2 CCO 和 STA 典型组网示意图



5 关键物料清单

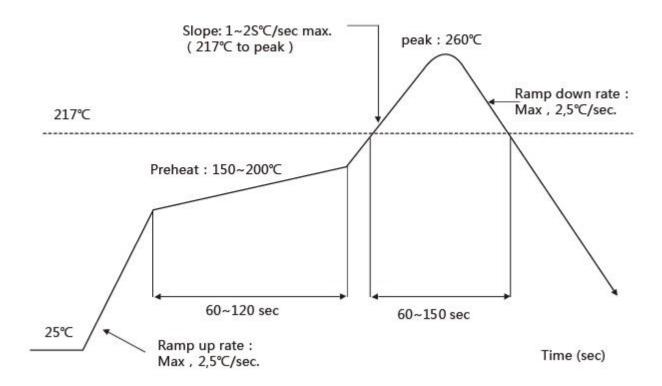
序号	物料名称	物料描述	厂商
1	IC	PS0211 QFN-48	
2	晶体	3225, 25MHz, 10ppm	东晶、泰晶、鸿星、晶威特
3	PCB	FR4, 4 Layer, 黑色	翔宇、顺络、科翔



6 推荐回流焊曲线

参照 IPC/JEDEC 标准

峰值温度: <260°C 次数: ≤2 times

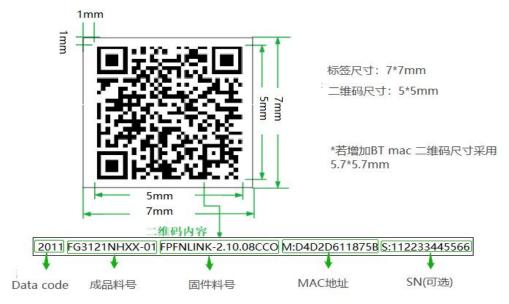




7 标签信息

7.1 模组标签

出货模组上,每个模组都贴有标签二维码,标签二维码信息内容如下:



7.2 包装标签

出货模组,在内包装(如静电袋)以及外箱纸盒上,贴有标签的信息内容如下:



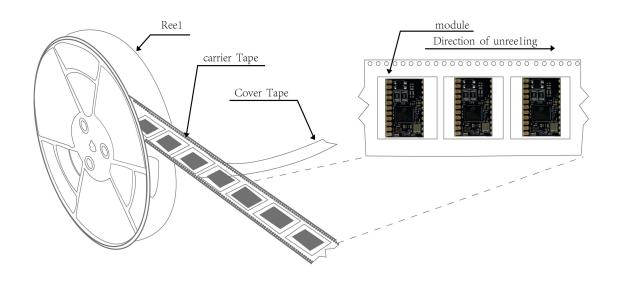


8 包装信息

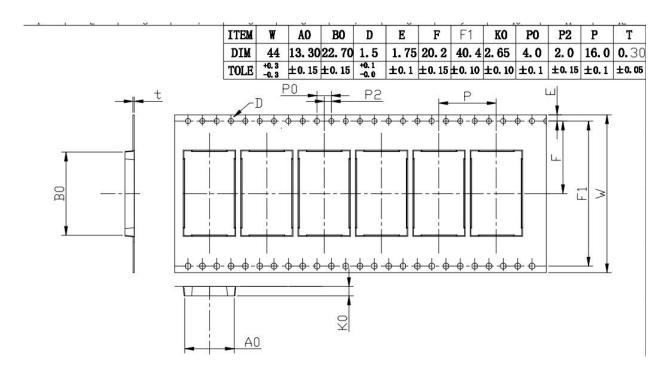
8.1 编带方式

出货采用载带包装,一卷 1500pcs

(注: 结合实际订单情况,会根据订单调整数量信息)



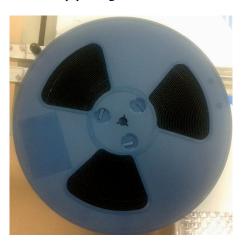
8.2 编带尺寸





8.3 其他包装信息

the take-up package



Using self-adhesive tape

Size of black tape: 24mm*32.6m the cover tape :21.3mm*32.6m

Color of plastic disc: blue



NY bag size:460mm*385mm



size: 350*350*35mm

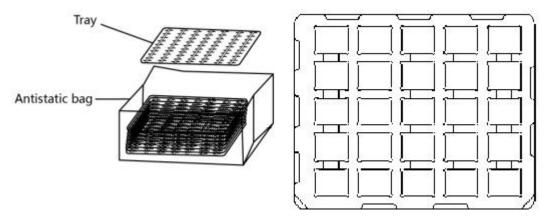


The packing case size:350*210*370mm



8.4 备用吸塑包装方式及其他

Use pallet packaging for less than 300 pieces



9. 湿度敏感性

根据 IPC/JEDEC J-STD-020 标准,模块为 3 级湿度敏感设备,请小心使用这种组件的所有相关要求。此外,客户必须注意以下情况:

- a) 密封袋中的计算保质期:在<40°C和<90%相对湿度(RH)下12个月。
- b) 生产过程中的环境条件:根据 IPC/JEDEC J-STD-033A 第 5 段,30° C/60%RH。
- c) 如果条件允许,打开密封袋和回流过程之间的最长时间必须为 168 小时
- b) 遵守"IPC/JEDEC J-STD-033A 第 5.2 段"
- d) 如果不遵守条件 b) 或 c),则需要烘烤
- e) 如果袋内湿度指示器指示相对湿度大于等于 10%,则需要烘烤